

< Program >

♠ 4월 5일(목)

시간	행사 및 발표	발표자
12:30-	등 록	
13:00-13:10	개회사	박용철(엠코코리아)
	특별 Session 1	좌장:
13:10-13:30	특1) 나노포러스금에서의 압입크기효과	김영천(안동대학교)
13:30-13:50	특2) MEMS 패키지 동향 및 저가화	박타준(삼성전기)
13:50-14:10	특3) 다양한 분야에 적용 가능한 레이저 기반 접합 기술	최광성(ETRI)
14:10-14:20	Coffee Break	
14:20-14:40	특4) 마그네트론 스퍼터링법으로 증착된 몰리브데늄 및 텅스텐 박막의 잔류 응력 제어	최두호(동의대학교)
14:40-15:00	특5) 지능형 설비 고장예지진단 기술 및 사례 소개	권대일(UNIST)
15:00-15:20	특6) 보드레벨 신뢰성에서 고성능을 구현하는 웨이퍼레벨 CSP	강원준(엠코코리아)
15:20-15:40	특7) 마이크로 LED 디스플레이 화소기술 개발현황	김영우(KOPTI)
15:40-16:30	포스터 Session	좌장: 박영배(안동대학교)
	특별 Session 2 (故 김정일 회장님 추모)	좌장: 정승부(성균관대학교)
16:30-16:50	특8) Technology for Higher Bandwidth, Homogeneous, and Heterogeneous Interconnection	김진영(엠코코리아)
16:50-17:10	특9) TBA	김덕훈(옵토펙(주))
17:10-17:30	특10) TBA	김영호(한양대학교)
17:30-17:40	감사패 증정	
17:40-18:10	간담회	

♠ 4월 6일(금)

시간	행사 및 발표	발표자
10:00-	등 록	
	Session 1	좌장:
10:20-10:35	연1) Graphene Oxide첨가에 따른 Sn-3.0Ag-0.5Cu 무연솔더 범프의 Electrogration 손상기구 분석	손기락(안동대학교)
10:35-10:50	연2) EDTA를 이용한 Cu 입자 상 두꺼운 Ag shell 형성 및 코어-셸 입자에서의 결함 제어	최은별(서울과학기술대학교)
10:50-11:05	연3) 2um 재 배선 층 기술을 위한 CMP 공정 개발	김시원(엠코코리아)
11:05-11:15	Coffee Break	
11:15-11:30	연4) 조종 가능한 마이크로 카테터를 위한 폴리머 액추에이터의 제작 공정	강수민(KAIST)
11:30-11:45	연5) 양면 몰드 기술을 이용한 Warpage 개선	고용재(엠코코리아)
11:45-12:00	연6) Fabrication of Vertically Oriented ZnO Micro-crystals array embedded in Polymeric matrix for Flexible Device	양동원(한양대학교)
12:00-13:00	중 식	
	Session 2	좌장:
13:00-13:15	연7) 스커터루다이트 접합을 위한 저온 TLP 접합 방법 개발	Sri Harini Rajendran (서울시립대학교)
13:15-13:30	연8) FOWLP 적용을 위한 열처리에 따른 Cu RDL계면 접착력에 미치는 영향 분석	김가희(안동대학교)
13:30-13:45	연9) 플렉싱 언더필 소재의 플렉싱 기능 정량화	장건수(ETRI)
13:45-13:55	Coffee Break	
	Session 3	좌장:
13:55-14:10	연10) 갈바닉 치환 반응에 의해 제조된 구리 덴드라이트의 성장 거동 및 특성 분석	황준호(서울과학기술대학교)
14:10-14:25	연11) 마이크로 사이즈 GaN LED와 트랜스퍼 프린팅	이주승(성균관대학교)
14:25-14:40	연12) 몰디드 서브스트레이트 패키지 소개	방원배(엠코코리아)